

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СНЭТ 21.02.110.000 СБ

Top side components

Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
1	Top Overlay				
2	Top Solder	Solder Resist	0,020mm	3,5	
3	Top Layer	Copper	0,035mm		
4	Dielectric 1	Prepreg FR-4	0,320mm	4,2	
5	Mid Layer 1	Copper	0,035mm		
6	Dielectric 2	Core FR-4	0,710mm	4,2	
7	Mid Layer 2	Copper	0,035mm		
8	Dielectric 3	Prepreg FR-4	0,320mm	4,2	
9	Bottom Layer	Copper	0,035mm		
10	Bottom Solder	Solder Resist	0,020mm	3,5	
11	Bottom Overlay				

- * Reference dimensions.
- To make installation of components according to the drawing and BOM: CB-2_v01c-BOM(2018.06.15).xls
- Elements for surface mounting should be mounted symmetrically to pads.
- Elements position 1(R32), 2(R70), 3(R73), 4(C43), 5(C42), 7(FU1) do not install.
- Element position 6(RT2) install at the level of the heat-conducting surface of Power Module (A1).
- Solder Sn60Pb40 or an analog in coordination with the producer. Soldering paste N82CR32AgS59.5 (for SMD elements).
- Printing conductors aren't shown.
- Designations of elements correspond to the scheme СНЭТ ПУ 00.00.02.000 Э3.

СНЭТ 21.02.110.000 СБ

Control Board (CB-2)

Assembly Drawing

Лист	1	Масса	Масштаб
Лист	1	Листов	2

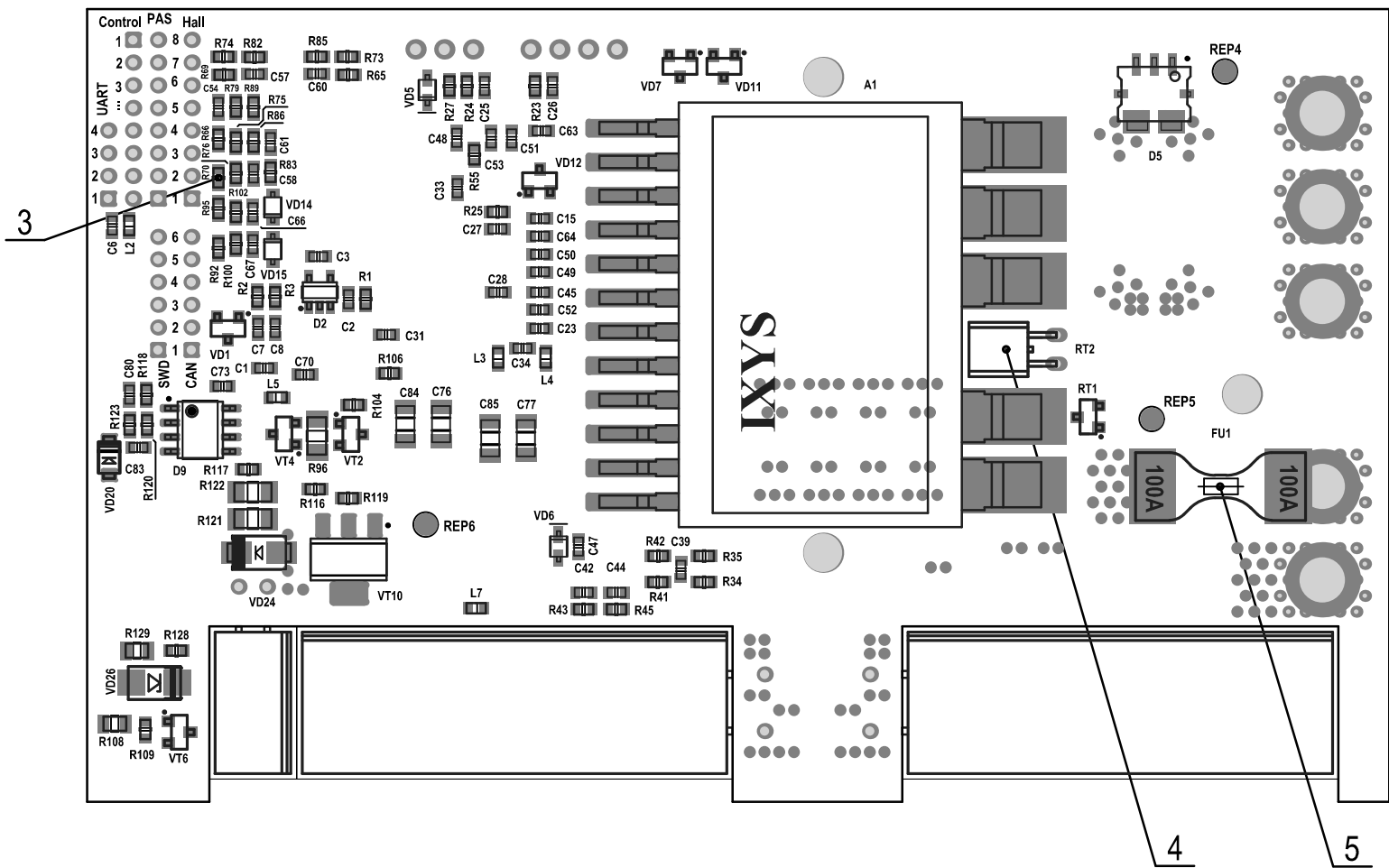
SINtech

B&E INVERTER

Копировал

Формат А4

Bottom side components



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СИЭТ 21.02.110.000 СБ	Лист
						2